

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# OMNIVISION®

**OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.**

**豪威集成電路(集團)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0501)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，豪威集成電路(集團)股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命  
豪威集成電路(集團)股份有限公司  
董事長  
虞仁榮先生

中國上海  
2026年5月22日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事虞仁榮先生、高文寶博士、吳曉東先生及仇歡萍女士；(ii)非執行董事呂大龍先生及陳瑜女士；及(iii)獨立非執行董事朱黎庭先生、范明曦女士及牟磊先生。

证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2026-054

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

## 豪威集成电路（集团）股份有限公司 关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 前次债项评级：AA+，主体评级 AA+，评级展望：稳定
- 本次债项评级：AA+，主体评级 AA+<sub>sti</sub>，评级展望：稳定

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所债券上市规则》等相关规定，豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对公司已发行的 A 股可转换公司债券（债券简称：“韦尔转债”）进行了跟踪信用评级。

公司前次主体长期信用评级结果为“AA+”，前次评级展望为“稳定”；韦尔转债前次评级结果为“AA+”；评级机构为新世纪评级，评级时间为 2025 年 6 月 12 日。

新世纪评级在对公司经营状况、行业情况等进行分析与评估的基础上，于 2026 年 5 月 21 日出具了《豪威集成电路（集团）股份有限公司韦尔转债定期跟踪评级报告》[新世纪跟踪(2026)100010]，本次公司主体长期信用评级结果为“AA+<sub>sti</sub>”，评级展望为“稳定”；韦尔转债评级结果为“AA+”。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告《豪威集成电路（集团）股份有限公司韦尔转债定期跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），敬请广大投资者查阅。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2026-055

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

## 豪威集成电路（集团）股份有限公司

### 关于实施 2025 年年度权益分派时

### “韦尔转债”停止转股的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因公司实施 2025 年年度权益分派，豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：2025 年年度权益分派公告前一交易日（2026 年 5 月 28 日）至权益分派股权登记日期间，“韦尔转债”将停止转股。

| 证券代码   | 证券简称 | 停复牌类型   | 停牌起始日     | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|--------|------|---------|-----------|------|-------|-----|
| 113616 | 韦尔转债 | 可转债转股停牌 | 2026/5/28 |      |       |     |

#### 一、 权益分派方案的情况

2026 年 5 月 7 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，确定以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计分配现金红利总额为 125,715,291.20 元（含税）。

如在公司实施权益分派前，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn/>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）、《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-047）。

本次权益分派方案实施后，公司将根据《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对“韦尔转债”当期转股价格进行调整。

## 二、 本次权益分派方案实施时停止转股的安排

（一）公司将于 2026 年 5 月 29 日在指定信息披露媒体上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自本次权益分派公告前一个交易日（2026 年 5 月 28 日）至权益分派股权登记日期间，“韦尔转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“韦尔转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在 2026 年 5 月 27 日（含 2026 年 5 月 27 日）之前进行转股。

## 三、其他

联系人：公司证券投资部

咨询电话：021-50805043

电子邮箱：will\_stock@corp.ovt.com

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日






内部编号: 2026050060

豪威集成电路(集团)股份有限公司

韦尔转债

# 定期跟踪评级报告

项目负责人: 黄梦姣  hmj@shxsj.com  
郝泽  haoze@shxsj.com  
项目组成员:  
评级总监: 张明海 

联系电话: (021) 63501349

联系地址: 上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层

公司网站: www.shxsj.com



上海新世纪资信评估投资服务有限公司  
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

## 声明

除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。

本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。

本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的真实性、准确性和完整性由资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见，但不对专业机构出具的专业意见承担任何责任。

本报告并非是某种决策的结论、建议。本评级机构不对发行人使用或引用本报告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。本报告的评级结论及相关分析并非对评级对象的鉴证意见。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。

本次跟踪评级的信用等级自本跟踪评级报告出具之日起至被评债券本息的约定偿付日有效。在被评债券存续期内，本评级机构将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象（或债券）实施跟踪评级并形成结论，决定维持、变更或终止评级对象（或债券）信用等级。本次跟踪评级的前一次债券（跟踪）评级有效期为前一次债券（跟踪）评级报告出具日至本报告出具日止。

本报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载、散发、出售或以其他方式外传。

未经本评级机构书面同意，本报告、评级观点和评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动。本评级机构对本报告的未授权使用、超越授权使用和不当使用行为所造成的一切后果均不承担任何责任。

## 跟踪评级概要

编号：【新世纪跟踪(2026)100010】

评级对象：豪威集成电路（集团）股份有限公司韦尔转债

韦尔转债

主体/展望/债项/评级时间

本次跟踪：AA<sup>+</sup><sub>st</sub>稳定/AA<sup>+</sup>/2026年5月21日

前次跟踪：AA<sup>+</sup>稳定/AA<sup>+</sup>/2025年6月12日

首次评级：AA<sup>+</sup>稳定/AA<sup>+</sup>/2020年8月3日



### 跟踪评级观点

#### 主要优势：

- 市场地位较突出。豪威集团为全球前三大图像传感器供应商之一，市场地位较突出，此外公司在模拟和显示等细分市场也具备了较强的竞争力。
- 研发实力强。豪威集团研发体系完备，研发投入规模大，目前持有的专利数量较多，产品技术含量较高，有助于维持公司市场竞争地位。
- 融资渠道畅通。豪威集团作为上市公司，可通过发行股权、银行贷款等多渠道进行融资，目前公司与多家商业银行建立良好的信贷合作关系，可使用授信额度较为充足。

#### 主要风险：

- 资产减值风险。近年来，豪威集团持续计提一定规模的存货跌价准备，目前公司存货规模仍较大，需持续关注存货跌价损失风险。
- 持续研发投入压力和技术更替风险。豪威集团持续研发投入规模很大，但半导体行业技术更替速度快，若公司产品和在研项目发生技术更替，则将对经营和研发规划造成一定负面影响。
- 供应商集中度高。豪威集团半导体产品生产和封装测试环节的主要环节外包，供应商集中度高。虽然目前公司与供应商合作稳定，但若国际贸易形势发生变化或供应商自身经营出现波动及合作关系发生变化，则将对公司供货稳定性造成较大影响。
- 产品出口风险。豪威集团境外收入占比高，国际贸易形势变化可能对其产品销售产生较大影响，此外汇率波动对其经营效益也有一定影响。
- 股权投资风险。跟踪期内，豪威集团对外股权投资规模大，较集中于半导体技术与产品领域，相关行业景气度波动大，目前投资标的产能尚在爬坡期，净利润持续亏损，后续需持续关注投资进展、投资标的经营状况及对公司的影响。
- 治理风险。豪威集团部分研发团队位于海外，并由海外子公司的管理团队负责运营和管理，后续需关注相关人员若发生变动对公司带来的风险。

### 跟踪评级结论

通过对豪威集团主要信用风险要素及影响上述债项偿付安全性相关因素的跟踪分析与评估，本评级机构认为其跟踪期内信用质量无实质性变化，决定维持主体信用等级 AA<sup>+</sup><sub>st</sub>，评级展望稳定，并维持韦尔转债 AA<sup>+</sup>信用等级。

### 未来展望

本评级机构预计豪威集团信用质量在未来 12 个月持稳，给予其主体信用评级展望为稳定。

### 主要财务数据及指标

| 项目                | 2023 年/末 | 2024 年/末 | 2025 年/末 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| <b>母公司口径数据:</b>   |          |          |          |
| 货币资金[亿元]          | 23.21    | 1.24     | 2.52     |
| 刚性债务合计[亿元]        | 104.35   | 93.40    | 78.89    |
| 所有者权益[亿元]         | 211.94   | 208.22   | 220.20   |
| 经营性现金净流入量[亿元]     | 4.29     | 3.42     | -11.79   |
| <b>合并口径数据及指标:</b> |          |          |          |
| 总资产[亿元]           | 377.43   | 389.65   | 436.01   |
| 总负债[亿元]           | 162.48   | 147.62   | 154.47   |
| 刚性债务[亿元]          | 107.95   | 95.65    | 95.39    |
| 所有者权益[亿元]         | 214.95   | 242.02   | 281.54   |
| 营业收入[亿元]          | 210.21   | 257.31   | 288.55   |
| 净利润[亿元]           | 5.44     | 32.84    | 40.32    |
| 经营性现金净流入量[亿元]     | 75.37    | 47.72    | 41.20    |
| EBITDA[亿元]        | 23.92    | 49.00    | 62.10    |
| 毛利率[%]            | 21.76    | 29.44    | 30.63    |
| 毛利率*[%]           | 19.54    | 27.28    | 28.68    |
| 净资产收益率[%]         | 2.75     | 14.37    | 15.40    |
| 资产负债率[%]          | 43.05    | 37.89    | 35.43    |
| 权益资本与刚性债务比率[×]    | 1.99     | 2.53     | 2.95     |
| EBITDA/利息支出[×]    | 4.48     | 15.00    | 20.53    |
| EBITDA/刚性债务[×]    | 0.20     | 0.48     | 0.65     |
| 流动比率[%]           | 223.45   | 287.07   | 210.28   |

注：根据豪威集团经审计的 2023~2025 年财务数据整理、计算。

### 发行人本次评级模型分析表

适用评级方法与模型：工商企业评级方法与模型（科技创新企业）FM-GS028（2024.4）

| 评级要素   |        | 结果                             |                 |
|--------|--------|--------------------------------|-----------------|
| 个体信用   | 业务风险   | 2                              |                 |
|        | 财务风险   | 1                              |                 |
|        | 初始信用级别 |                                | aa <sup>+</sup> |
|        | 调整因素   | 合计调整（子级数量）                     | /               |
|        |        | 其中：①流动性因素                      | /               |
|        |        | ②业务多元化因素                       | /               |
|        |        | ③科技赋能因素                        | /               |
|        |        | ④ESG 因素                        | /               |
|        |        | ⑤表外因素                          | /               |
|        | ⑥其他因素  | /                              |                 |
| 个体信用级别 |        | aa <sup>+</sup>                |                 |
| 外部支持   | 支持因素   | /                              |                 |
| 主体信用级别 |        | AA <sup>+</sup> <sub>sti</sub> |                 |

调整因素：（/）

不涉及。

支持因素：（/）

不涉及。

### 相关评级技术文件及研究资料

| 相关技术文件与研究资料名称                       | 链接  |
|-------------------------------------|---|
| 《新世纪评级方法总论（2022版）》                  | <a href="http://www.shxsj.com/page?template=8&amp;pageid=26739&amp;mid=4&amp;listype=1">http://www.shxsj.com/page?template=8&amp;pageid=26739&amp;mid=4&amp;listype=1</a>     |
| 工商企业评级方法与模型（科技创新企业）FM-GS028（2024.4） | <a href="http://www.shxsj.com/page?template=8&amp;pageid=30250&amp;cid=114&amp;listype=1">http://www.shxsj.com/page?template=8&amp;pageid=30250&amp;cid=114&amp;listype=1</a> |
| 《半导体行业 2025 年信用回顾与 2026 年展望》        | <a href="http://www.shxsj.com/page?template=8&amp;pageid=35456&amp;cid=91&amp;listype=1">http://www.shxsj.com/page?template=8&amp;pageid=35456&amp;cid=91&amp;listype=1</a>   |

# 跟踪评级报告

## 跟踪评级原因

按照豪威集成电路（集团）股份有限公司<sup>1</sup>（简称“豪威集团”、该公司或公司）韦尔转债（简称“韦尔转债”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据豪威集团提供的经审计的 2025 年财务报表及相关经营数据，对豪威集团的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2020 年 12 月发行本金为 24.40 亿元的韦尔转债，期限 6 年。该债券转股期为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日，目前转股价格为 159.12 元/股。截至 2025 年末，累计 760.2 万元（35,059 股）“韦尔转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.31%，未转股的“韦尔转债”金额为 243,239.40 万元，占可转债发行总量的 99.69%。截至 2025 年末，公司尚在存续期债务融资工具情况如图表 1 所示。

图表 1. 公司存续债券/债务融资工具基本情况

| 债项名称 | 发行金额<br>(亿元) | 期限<br>(天/年) | 最新利率<br>(%) | 发行时间       | 注册额度/注册时间            | 备注               |
|------|--------------|-------------|-------------|------------|----------------------|------------------|
| 韦尔转债 | 24.40        | 6 年         | 2.00        | 2020.12.28 | 24.40 亿元/2020 年 12 月 | 余额 24.32 亿元，正常付息 |

资料来源：豪威集团

该公司“韦尔转债”实际募集资金净额为 23.87 亿元，拟用于募投项目“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”、“CMOS 图像传感器研发升级”的项目建设以及补充流动资金。2021 年 7 月，公司变更募集资金投资项目，将“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”<sup>2</sup>项目募集资金使用金额中 11.17 亿元变更用于“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”（7.56 亿元）、“高性能图像传感器芯片测试扩展项目”（2.10 亿元）和“硅基液晶投影显示芯片封测扩展项目”（0.82 亿元）<sup>3</sup>。上述所有募投项目均已于 2024 年度实施完毕并结项，跟踪期内公司将募集资金专户中累计 38,214.06 万元（含利息收入）转入公司其他账户永久补充流动资金，并已完成相关募集资金专户销户工作。

图表 2. 截至 2025 年末，本次债券募集资金使用情况（单位：亿元）

| 项目名称               | 计划投资总额            | (变更前)<br>拟使用募集<br>资金金额 | (变更后)<br>拟使用募集<br>资金金额 | 已使用募集<br>资金金额 <sup>4</sup> | 项目达到预定<br>可使用状态 |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| 晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期） | 8.28 <sup>5</sup> | 13.00                  | 1.84                   | 1.85                       | 2022 年 10 月     |
| CMOS 图像传感器研发升级项目   | 13.64             | 8.00                   | 8.00                   | 4.38                       | 2024 年 3 月      |
| 补充流动资金             | 2.87              | 2.87                   | 2.87                   | 2.87                       | —               |
| 晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目    | 8.80              | —                      | 8.35                   | 8.40                       | 2024 年 12 月     |
| 高性能图像传感器芯片测试扩展项目   | 2.23              | —                      | 2.09                   | 2.10                       | 2023 年 1 月      |
| 硅基液晶投影显示芯片封测扩展项目   | 0.91              | —                      | 0.73                   | 0.82                       | 2023 年 8 月      |
| 合计                 | 36.74             | 23.87                  | 23.89                  | 20.42                      | —               |

资料来源：豪威集团

<sup>1</sup> 2025 年 6 月，该公司名称由“上海韦尔半导体股份有限公司”变更为“豪威集成电路（集团）股份有限公司”，英文名称从“Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai”变更为“OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.”，证券简称从“韦尔股份”变更为“豪威集团”，证券代码保持“603501”不变。

<sup>2</sup> 晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）原计划实现新增 12 吋晶圆测试量 42 万片/年、12 吋晶圆重构量 36 万片/年，项目达产后预计实现年均销售收入 7.42 亿元、年均净利润 2.05 亿元。变更后实现新增 12 吋晶圆测试量 18 万片/年、12 吋晶圆重构量 18 万片/年，项目达产后预计实现年均销售收入 3.43 亿元、年均净利润 1.24 亿元。

<sup>3</sup> 晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目达产后预计实现年均销售收入 4.21 亿元、年均净利润 1.04 亿元；高性能图像传感器芯片测试扩展项目达产后预计实现年均销售收入 1.02 亿元、年均净利润 0.28 亿元；硅基液晶投影显示芯片封测扩展项目达产后预计实现年均销售收入 2.04 亿元、年均净利润 0.27 亿元。

<sup>4</sup> 因募集资金存放期间产生了利息收益，部分募投项目实际使用资金略超过拟使用募集资金金额。

<sup>5</sup> 项目原计划投资总额为 183,919.98 万元，调整后为 82,815.62 万元。

## 数据基础

本评级报告的数据来自于该公司提供的 2023-2025 年财务报表，以及相关经营数据。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023-2025 年财务报表进行了审计，并均出具了标准无保留意见的审计报告。公司执行财政部颁发的企业会计准则及其相关规定。

2023-2025 年末，该公司合并范围内子公司数量较上年末分别减少 2 家、1 家和 0 家，公司合并范围变化对财务状况影响较小，公司最近三年财务数据具有可比性。

## 业务

该公司为国内领先的 Fabless 模式半导体企业，主要从事半导体产品设计及销售、电子元器件代理及销售业务。公司主业市场地位稳固，主要产品在各自的细分市场具有较强的市场竞争力。公司终端客户较集中于消费电子产品行业，2025 年以来受益于公司在汽车智能驾驶领域的持续渗透以及在全景、运动相机等领域的拓展，业绩持续增长。2026 年第一季度，受存储芯片等产品供需关系出现阶段性扰动影响，当期公司营业收入同比有所下滑；同时当期公司半导体代理业务收入占比提升，导致公司整体毛利水平略有下降。需关注公司下游领域市场需求变化对公司经营业务影响情况。公司营业收入以境外为主，需持续关注国际贸易形势变化可能对公司产生的影响。公司半导体产品生产及封测主要环节外包，业务运营易受与核心供应商的合作稳定性影响。目前公司存货占款规模较大，需持续关注运营资金占用和存货跌价损失风险。

### 1. 外部环境

#### （1）宏观因素

2026 年一季度，我国经济在动荡复杂的外部环境下实现了超预期增长、价格水平改善，展现出较强韧性。随着新动能的持续发展壮大和宏观政策的大力支持，我国经济有望保持稳定增长，长期向好的基本面依然稳固。

2026 年一季度，全球经济金融受地缘政治事件冲击剧烈波动，能源价格中枢抬升引发滞胀担忧，全球经济贸易格局正在深度重构，新旧产业景气度分化态势持续。新一轮科技革命和产业变革，以及大国关系牵动世界形势更加复杂多变，将是一段时期内影响我国经济发展举措的关键外部环境因素。

2026 年一季度，我国经济在动荡复杂的外部环境下实现了超预期增长、价格水平改善，展现出较强韧性。工业和服务业增加值增速保持较快增长，细分行业表现分化依然明显，非金属矿采选、石油煤炭及其他燃料加工、化学原料及化学制品等少部分传统产业和铁路船舶运输设备制造、计算机通信和其他电子设备制造、电气机械和器材制造、信息技术服务等高技术制造与高技术服务业的生产及利润表现相对较好。服务消费、通讯器材以及金银珠宝消费增速较快，而总体消费增长仍偏低，居民消费能力和意愿还需要进一步增强；基础设施建设投资和制造业投资改善，房地产开发投资降幅收窄但仍较大；在人民币汇率升值的背景下，机电等高新技术产品出口高速增长带动整体出口表现强势，出口去向区域结构多元化成效显著，对东盟、非洲、欧盟出口的增长有效地对冲了对美国出口的下滑。

长期看，在构建“双循环”发展新格局的大框架下，我国对外坚持扩大高水平对外开放，大力拓展区域伙伴关系，优化对外贸易区域结构；对内建设全国统一大市场，做强国内大循环，培育壮大新动能，提升产业链自主可控水平，持续防范化解重点领域风险，以高质量发展的确定性应对外部不确定性。短期看，围绕扩大内需和促进科技创新，宏观政策给予定向支持的政策倾向更为突出。央行采取适度宽松的货币政策，加大结构性货币政策力度，引导金融资源流向关键领域；积极财政政策保持较高的支出力度，通过优化财政支出结构提升财政资金使用效率，同时强化财政金融协同与地方财力保障，为经济发展提供坚实支撑。

我国仍处于转变发展方式、转换增长动力的攻关期，经济增长面临压力且行业表现分化是基本特征。随着新动能的持续发展壮大和宏观政策的大力支持，2026 年我国经济有望继续保持稳定增长；深入实施提振消费专项行动以及居民增收计划，有利于庞大的市场潜能释放，消费增速温和提升；地产投资降幅收窄，财政主导的基建和

设备更新政策支持制造业升级带动投资增速回稳，投资向高端制造、战略基础设施和绿色转型等领域倾斜的趋势更加明显；出口在供应链完备高效、产品性价比高、去向区域结构多元化下保持韧性。制度优势、发展韧性以及转型升级成效的综合作用下，我国经济长期向好的基本面依然稳固。

## (2) 行业因素

2025 年以来，AI 已成为驱动半导体产业进入高景气周期的核心推动力，大模型迭代升级、终端智能场景渗透深化创造需求增长极，叠加智能手机、PC 等传统终端市场需求企稳回暖，集成电路设计行业重回高速增长轨道。根据中国半导体行业协会集成电路设计分会数据，2025 年我国 IC 设计行业规模约为 8,357.3 亿元，同比增长 29.4%，增速显著提升。在国产替代需求驱动下，国家以税收补贴、产业基金等政策持续扶持本土半导体行业，引导长期资本聚焦核心环节，并购重组政策有力支持龙头企业整合成长。目前全球集成电路设计业集中度高，国内部分企业已达到国际先进水平，但行业企业数量多、规模偏小，资源较为分散，在高端通用型芯片设计领域市场占有率仍极低，核心竞争力有待提升。为提升竞争力，IC 设计企业仍需维持较高强度研发投入，受客户导入、产品推广成本高企及竞争加剧等因素影响，部分企业面临盈利能力弱化风险。

展望 2026 年，AI 服务器需求提升及 AI 终端创新应用深化将持续推动集成电路设计产业规模增长，AI 仍是行业发展核心驱动力。在国产化替代逻辑下，具备核心研发能力、技术实现突破并能通过客户认证的龙头企业将率先受益并优先获取市场份额。政策引导与市场竞争驱动下的产业整合，将有利于行业高质量发展转型，但核心设备与关键材料对外依存度高、研发投入持续承压等风险较为突出。

详见：《半导体行业 2025 年信用回顾与 2026 年展望》

## 2. 业务运营

图表 3. 公司核心业务收入及变化情况

| 主导产品或服务            | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| 营业收入合计（亿元）         | 210.21 | 257.31 | 288.55 |
| 其中：（1）半导体设计及销售（亿元） | 179.40 | 216.40 | 238.00 |
| 在营业收入中占比（%）        | 85.35  | 84.30  | 82.48  |
| （2）半导体代理销售（亿元）     | 29.70  | 39.39  | 49.05  |
| 在营业收入中占比（%）        | 14.13  | 15.34  | 17.00  |
| 毛利率（%）             | 21.76  | 29.44  | 30.63  |
| 其中：（1）半导体设计及销售（%）  | 23.87  | 33.31  | 34.97  |
| （2）半导体代理销售（%）      | 6.59   | 7.31   | 7.85   |

注：根据豪威集团提供的数据整理、计算。

该公司是一家主要从事芯片设计业务的 Fabless 芯片设计公司，主要涉及半导体设计及销售业务和半导体代理销售业务。目前公司半导体设计业务聚焦图像传感器解决方案、显示解决方案、模拟解决方案三大核心板块，作为全球第三大数字成像解决方案提供商，公司产品已覆盖汽车、智能手机、家居安防、医疗、工业/机器视觉、新兴市场等领域；此外公司还涉及半导体代理销售业务，相关产品主要为电子元件、结构器件等，覆盖移动通信、家用电器、安防、智能穿戴等诸多领域。2023-2025 年，公司分别实现营业收入 210.21 亿元、257.31 亿元和 288.55 亿元。2025 年以来，受益于公司产品在汽车智能驾驶领域的持续渗透以及在全景、运动相机等新兴智能终端影像应用市场的扩张，半导体设计及销售收入同比增长 9.98%，整体营业收入同比增长 12.14%，同时受益于产品结构优化以及供应链梳理等因素，当年公司毛利率水平持续增长，同比提升 1.19 个百分点。

2025 年，该公司半导体设计及销售业务实现营业收入 238.00 亿元，其中图像传感器解决方案、显示解决方案和模拟解决方案营业收入占半导体设计及销售业务营业收入比分别为 89.27%、3.95%和 6.78%。

图表 4. 公司半导体设计及销售业务收入及变化情况

| 主导产品或服务              |        | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 半导体设计及销售业务营业收入合计（亿元） |        | 179.40 | 216.40 | 238.00 |
| 其中：图像传感器解决方案业务       | 金额（亿元） | 155.36 | 191.90 | 212.46 |
|                      | 占比（%）  | 86.60  | 88.68  | 89.27  |

| 主导产品或服务  |         | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 |
|----------|---------|--------|--------|--------|
| 显示解决方案业务 | 金额 (亿元) | 12.50  | 10.28  | 9.41   |
|          | 占比 (%)  | 6.97   | 4.75   | 3.95   |
| 模拟解决方案业务 | 金额 (亿元) | 11.54  | 14.22  | 16.13  |
|          | 占比 (%)  | 6.43   | 6.57   | 6.78   |

注：根据豪威集团提供的数据整理、计算。

该公司图像传感器解决方案产品主要包括 CMOS 图像传感器、硅基液晶投影显示芯片 (LCOS)、微型影像模组封装 (CameraCubeChip) 和特定用途集成电路产品 (ASIC) 等。2025 年, 公司图像传感器解决方案实现营业收入 212.46 亿元、毛利率 35.98%, 同比分别增长 10.71% 和提高 1.46 个百分点。分领域来看, 其在智能手机、汽车电子、新兴市场分别实现收入 82.72 亿元、74.71 亿元和 23.69 亿元, 分别占当年公司图像传感器解决方案营业收入的 38.94%、35.16% 和 11.15%。其中智能手机市场为公司图像传感器解决方案业务的第一大收入来源, 2025 年受智能手机出货量下降、补贴规模收敛及主力产品周期切换影响, 来自智能手机领域的业务收入同比下降 15.61%; 同时, 随着汽车产业自动驾驶系统及舱内驾驶员监控系统的持续渗透, 车用图像传感器等汽车电子产品需求不断提升, 2025 年公司在汽车市场的业务收入同比增长 26.52%, 近年来保持稳定增长; 此外, 受益于户外运动与短视频领域带动运动及全景相机快速发展, 以及智能眼镜产品在娱乐、医疗保健等多领域的加速落地等, 近年来运动及全景相机、智能眼镜、端侧 AI 及机器视觉等各类新兴市场推动图像传感器的需求逐步释放, 2025 年公司在新兴市场的收入同比大幅增长 211.85%。

2025 年该公司显示解决方案产品实现营业收入 9.41 亿元、毛利率 14.29%, 同比分别下降 8.47% 和增长 6.17 个百分点, 受手机 LCD-TDDI 市场需求下降及供给冗余的影响, 标准品价格持续承压, 该业务当年营业收入有所下滑, 但由于公司持续进行新产品开发、新市场拓展与降低供应链成本, 当年业务毛利率同比有所增长。

该公司模拟解决方案包含分立器件 (包括 TVS、MOSFET、肖特基等)、电源 IC 等产品, 主要用于消费类电子、汽车电子和安防等领域, 2025 年实现营业收入 16.13 亿元、毛利率 33.71%, 同比分别增长 13.43% 和减少 1.53 个百分点, 2025 年随着公司推进多款主力车载模拟产品的客户验证与批量导入, 当年车载模拟 IC 产品实现营业收入 2.96 亿元, 同比增长 47.54%, 为公司模拟解决方案业务收入的主要增量来源, 但由于市场竞争加剧, 当年业务毛利率同比有所下滑。

半导体代理销售业务是该公司的传统业务, 经过多年经营, 已在国内建立起完整的分销网络, 并与主要的电子元器件原厂建立了稳定的合作关系。除产品分销外, 公司还为客户提供各种产品应用咨询、方案设计支持、技术支持、售后服务、物流等整体解决方案。同时, 分销业务能够使公司更好了解下游市场需求的变动, 使公司半导体设计业务开发的产品能够顺应市场需求作出迅速反应, 形成一定的协同效应。

图表 5. 公司电子元器件代理及销售业务主要代理产品

| 产品名称 | 细分产品                             | 主要代理厂商  |
|------|----------------------------------|---|
| 电子元件 | 电阻、电容、电感、晶振等                     | 松下、国巨、乾坤、三星、华新科、华德、TXC 等  |
| 结构器件 | 连接器、卡座、卡托、PCB、喇叭、驻极体等            | 莫仕、松下、南亚、共达等  |
| 机电系统 | 伺服、电机、风扇、PLC 等                   | 松下、NIDEC、台达等  |
| 集成电路 | 芯片、Sensor、Memory、Flash、传感器、二三极管等 | 光宝、江波龙、XMC、昆腾微、景略、荣湃、力生美、芯昇、前海维晟、海栎创、爱芯、九天睿芯、国民技术、BOSCH、傅里叶、易冲等 |
| 射频器件 | 滤波器等                             | 松下、ACX、佳利、华莹、芯朴、华新科等  |

注：根据豪威集团提供的数据整理

该公司半导体代理销售业务采取买断式采购的模式, 目前公司代理的产品主要为各类电子元件、结构器件、机电系统、集成电路、射频器件等, 代理原厂均为各自行业的龙头企业, 产品下游需求稳定。2025 年, 受益于市场需求复苏, 下游电子、汽车、工业、新兴市场整体回暖, 代理销售业务销售收入有所回升, 当年公司半导体代理销售业务营业收入为 49.05 亿元, 同比增长 24.52%; 毛利率为 7.85%, 同比增加 0.54 个百分点。

根据该公司 2026 年 1 月披露的相关公告, 公司全资子公司韦尔半导体香港有限公司拟使用自有资金认购爱芯元智半导体股份有限公司 (简称“爱芯元智”) 于香港联合交易所有限公司 (简称“香港联交所”) 首次公开发行的股份, 预计认购总金额不超过 5,000 万美元。因公司董事长、控股股东及实际控制人虞仁荣先生持有爱芯元智本次公开发行前 1.12% 的股权, 根据相关规定, 公司本次参与认购爱芯元智公开发行的股份形成与关联方共同投资

的关联交易。根据公开信息，爱芯元智作为 AI 推理系统芯片（SoC）的供应商，主要涉及视觉终端、边缘推理及智能汽车三大业务线。截至 2025 年 9 月末，爱芯元智总资产为 30.29 亿元，净资产为-45.18 亿元，2025 年前三季度分别实现营业收入和净利润 2.69 亿元和-8.56 亿元。需关注本次投资的后续进展以及未来投资收益实现情况。

根据该公司于 2026 年 3 月披露的相关公告，公司拟以现金方式对荣芯半导体（宁波）有限公司（简称“荣芯半导体”）增资人民币 10 亿元以持有其约 3,218 万元注册资本，以本轮增资规模人民币 40 亿元计算，本次增资完成后公司预计持有其注册资本占比约为 5.88%，具体以各方最终签署的协议约定为准。因公司董事吕大龙先生通过其控制的西藏智通创业投资有限公司（简称“西藏智通”）持有荣芯半导体 4,000 万元注册资本，占其本轮增资前 9.65% 股权，公司关联方北京君正集成电路股份有限公司（简称“北京君正”）持有荣芯半导体 400 万元注册资本，占其本轮增资前 0.97% 股权。根据相关规定，公司本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。根据公开信息，荣芯半导体主营业务包括数模混合、模拟类和逻辑类集成电路的晶圆代工。截至 2025 年末，荣芯半导体总资产为 77.82 亿元，净资产为 51.63 亿元，2025 年度分别实现营业收入和净利润 3.03 亿元和-20.20 亿元。目前荣芯半导体处于前期产能爬坡过程中，未来亏损状态可能持续存在，其业务发展及与公司的技术协同等方面存在一定的不确定性，需关注本次投资的后续进展以及未来供应链整合、投资收益实现情况。

### （1）科技创新能力

近年来，该公司持续完善研发体系组织架构、制度建设和修订，在研发方面保持高强度投入且相对稳定。

研发体系组织架构方面，该公司成立了项目管理部、系统应用工程部、研发部、器件技术研发部、保护器件产品部、封装部、工艺部等部门。2023-2025 年，公司研发人员数量分别为 2,053 人、2,387 人和 2,681 人，研发人员占公司员工总人数比例保持在 40% 以上。近年来随着业务发展，公司研发人员数量持续增长，对高端技术人才需求加大，公司持续吸纳资深的专家型研发人才，并通过内培、外招等方式储备研发优秀人才。公司部分研发人员位于海外，由公司海外子公司 OmniVision Technologies, Inc.（简称“美国豪威”）的管理团队负责运营和管理，需关注后续可能产生的治理风险。

图表 6. 公司研发人员数量及占比

| 指标        | 2023 年末 | 2024 年末 | 2025 年末 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 研发人员数量（人） | 2,053   | 2,387   | 2,681   |
| 研发人员占比（%） | 42.77   | 44.40   | 43.52   |

注：根据豪威集团提供的数据整理

该公司依据《项目研发管理制度》等相关公司文件进行产品和技术研发管理。公司研发项目在开发立项前，需经过多道流程审批，审查标准或内容包括（1）集成电路布局的开发已经技术团队进行充分论证；（2）管理层已批准相关集成电路布局开发的预算；（3）前期市场调研的研究分析说明相关集成电路布局所生产的产品具有市场推广能力；（4）有足够的技术和资金支持，以进行相关集成电路布局的开发活动及后续的大规模生产；（5）相关集成电路布局开发的支出能够可靠地归集。研发项目方案提出以后提交行政部，行政部收集后提交证券投资部及公司总经理，由总经理决定是否组织总经理办公会讨论。总经理应该组织相关部门审查基本情况，根据实际情况可以决定是否聘请外部专家参与评议，并最终形成决议。形成决议后应安排专业分管副总组织实施。获得批准的研发项目方案须提交财务部门妥善安排资金并进行相应的财务处理；否决的研发项目方案由行政部将相关资料存档备案。研发过程中，项目研发负责人应该定期将项目进行情况向公司分管副总作出书面汇报，并提交行政部留案存档；公司总经理对研发项目进行跟踪检查，协调相关部门帮助解决各种问题，协调各方面的关系；内部审计部应定期不定期的对研发项目进行专项检查和审计，对违反本制度规定进行的研发项目提出处理意见及建议，并报公司董事长或公司董事会处理。研发项目结项后，组织相关部门对研发成果进行评价，并及时将评价结果上报公司相关领导，行政部负责对研发成果的管理，包括组织实施专利申请，项目过程和最终文档的存档备案，并负责项目研发的最终文档备案管理。总体来看，公司技术研发体系完备。

该公司作为国内半导体设计的领先企业，研发投入大。2023-2025 年公司研发投入分别为 29.27 亿元、32.45 亿元和 36.80 亿元，占营业收入的比重分别为 13.92%、12.61% 和 12.75%。公司主要以自有资金覆盖研发支出，目前相对充裕的货币资金能够为短期内研发资金提供很好的保证。公司半导体设计业务主要由图像传感器解决方案、显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系构成，其产品已经广泛应用于消费电子和工业应用领域，包括汽车、

智能手机、家居安防、医疗、工业/机器视觉、新兴市场等领域，并在各领域拥有多项专利技术。截至 2025 年末，公司已拥有授权专利 4,993 项，其中发明专利 4,787 项，实用新型专利 206 项。另外，公司拥有布图设计 136 项，软件著作权 86 项。总体上看，公司技术研发实力很强，有助于其在激烈的市场竞争中维持市场地位。

图表 7. 公司研发投入状况

| 指标             | 2023 年     | 2024 年     | 2025 年     |
|----------------|------------|------------|------------|
| 研发投入（万元）       | 292,666.44 | 324,529.31 | 367,953.97 |
| 其中：费用化研发投入（万元） | 223,413.46 | 262,208.68 | 284,287.29 |
| 资本化研发投入（万元）    | 69,252.98  | 62,320.64  | 83,666.68  |
| 研发投入/营业收入（%）   | 13.92      | 12.61      | 12.75      |

注：根据豪威集团提供的数据整理

## （2） 科技创新成果与应用

该公司所属行业为集成电路设计行业，核心技术重要程度很高。近年来公司核心技术主要应用于智能手机、汽车电子以及新兴市场，受益于相关领域下游需求增长以及新兴市场的开拓，2025 年公司营业收入持续增长。

该公司所处的集成电路设计产业属于集成电路产业的核心环节之一，是国家各项集成电路相关政策和战略规划重点关注的领域，其核心技术具有一定的重要性，能够得到政府一定的关注和支持。截至目前公司已获得了集成电路设计企业认定证书以及高新技术企业认证等认证，可享受税收优惠政策。

该公司半导体产品的生产及封装测试的主要环节外包给专业的晶圆代工厂商和封装测试厂商，流程主要为：公司将设计好的版图交由晶圆代工厂进行掩膜，以制作光罩。晶圆裸片由晶圆代工厂统一采购，并根据产品版图进行加工，之后公司采购由晶圆代工厂加工、测试后带有多层电路结构的晶圆，并交由封装测试厂商进行封装、测试，最终成品由公司进行销售。目前，公司产品的生产周期约为 4-6 个月，生产周期相对较长。

该公司与核心代工厂商和封测厂商建立了长期稳定的合作关系，主要合作的代工厂商和封测厂商均为行业领先企业，可有效保证公司产品质量和交货周期的稳定。2025 年公司半导体设计业务中，晶圆及封装测试费用占总成本的比例分别约为 71.23%和 17.32%，其余 11.45%成本由彩色滤光片、制造费用及运费等构成。2025 年公司前五大供应商采购额 133.64 亿元，因当年公司销售规模增长，前五大供应商采购额同比增长 16.45%；当年前五大供应商合计采购占比为 62.07%，较去年同期增长了 0.25 个百分点，集中度较高。近年来，供应商货款账期和结算方式基本保持稳定，晶圆代工厂商给予公司的账期平均约为 30 天，封测厂商给予的账期平均约为 60 天，主要采用银行转账的结算方式。公司采购的相关产品原产地主要为中国境内及中国台湾地区，关税政策对公司原材料采购的影响相对有限。

2025 年该公司前五大客户销售收入 142.86 亿元，同比增长 9.07%，合计销售占比为 49.58%，同比小幅下降 1.56 个百分点，客户集中度较高。由于晶圆加工周期较长，为满足客户交货需求，公司会备有一定量的存货。2022 至 2023 年公司为消化库存，对于生产节奏进行了控制，随着库存水位已降至较低水平，且近年来下游市场需求回暖，公司生产规模整体有所提升，2025 年图像传感器解决方案业务和模拟解决方案业务的生产量同比分别提升 23.11%和 20.62%，但显示解决方案业务由于市场供给冗余，当年生产量同比小幅下降 1.81%。2025 年，随着公司产品在汽车电子和新兴市场等领域的持续导入和拓展，当年图像传感器解决方案业务产品销量同比增长 10.90%，库存量同比增长 20.73%；模拟解决方案业务因当年车载模拟 IC 等产品市场需求增长，产品销量同比增长 13.61%，库存量同比增长 11.24%；显示解决方案业务产品受下游市场需求下降影响，当年销量同比下降 1.44%，库存量同比增长 7.70%。截至 2025 年末，公司产品库存量较上年同比增长 13.12%。公司销售收入主要来源于境外<sup>6</sup>，2025 年境外销售收入为 230.62 亿元，在当年主营业务收入中占比 80.04%，由于公司主要以美元结算，汇率变化将对收益产生一定影响。此外，公司销售的相关产品原产地主要为中国境内及中国台湾地区，虽然公司持续深化和优化供应链的全球化规划与布局，并已从下游客户所在地形成了供应链体系，但若未来关税等贸易政策发生变化，将对境外业务产生一定影响。

<sup>6</sup> 公司境内外收入的划分，主要是根据客户收货公司所在地，因此，境内外收入受到下游客户选用的收货公司所在地影响。公司境外地区收入主要是由维尔香港、香港华清和新加坡豪威等境外公司实现的，香港作为传统的国际电子产品集散地，较多的客户有在境外交货的需求。

图表 8. 2025 年公司半导体设计及销售业务分产品产销情况（单位：万颗，%）

| 项目          | 生产量                 | 同比           | 销售量                 | 同比           | 库存量               | 同比           |
|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 图像传感器解决方案业务 | 148,008.84          | 23.11        | 132,501.44          | 10.90        | 90,304.91         | 20.73        |
| 显示解决方案业务    | 15,688.34           | -1.81        | 15,300.01           | -1.44        | 5,429.22          | 7.70         |
| 模拟解决方案业务    | 1,156,700.23        | 20.62        | 1,124,145.33        | 13.61        | 322,094.44        | 11.24        |
| <b>合计</b>   | <b>1,320,397.41</b> | <b>20.57</b> | <b>1,271,946.78</b> | <b>13.11</b> | <b>417,828.57</b> | <b>13.12</b> |

注：根据豪威集团提供的数据整理、计算。

该公司图像传感器产品收入主要来源于智能手机、汽车电子及新兴市场等领域。智能手机方面，2025 年上半年受消费电子补贴政策及春节旺季带动，市场阶段性回升，但后续增长动力不足；下半年受需求提前释放、补贴规模收敛等因素影响，市场同比延续下滑趋势。根据 IDC 数据，2025 年中国智能手机市场出货量约 2.84 亿台，同比下降 0.6%；2026 年中国智能手机市场出货量预计仅为 2.55 亿部，同比下滑 10.5%。此外，叠加存储价格预计大幅上涨，手机厂商成本压力进一步加剧，IDC 预测成本压力将推动安卓旗舰机型价格进一步上探，智能手机市场将呈现高端化持续扩容、低端市场承压的格局。目前在高端智能手机 CIS 领域，公司已量产交付 5000 万像素一英寸高动态范围图像传感器 OV50X，且 2 亿像素图像传感器产品已通过客户验证并实现导入，根据群智咨询（Sigmaintell）预测，2027 年全球 2 亿像素手机 CIS 市场需求量有望突破 1 亿颗。整体来看，智能手机市场景气度后续或将有所波动，且产品结构呈现持续分化态势，在此背景下，公司持续强化在高端智能手机 CIS 领域的竞争优势，中长期增长空间广阔。

汽车电子方面，根据乘联会的数据，2025 年全球累计汽车销量达 9,647 万台，同比增长约 5%。同时，随着自动驾驶系统及舱内驾驶员监控系统渗透率快速提升，车载摄像头的需求显著增长。根据 Frost & Sullivan 的数据，全球汽车 CIS 市场由 2020 年的 1,377 百万美元增至 2024 年的 2,499 百万美元，年复合增长率为 16.1%，且预计自 2025 年起的年复合增长率为 18.4%，并于 2029 年达到 7,028 百万美元。该公司是全球领先的汽车图像传感器解决方案供应商，产品全面覆盖 ADAS、自动驾驶等应用场景，目前公司汽车电子产品已导入众多客户。

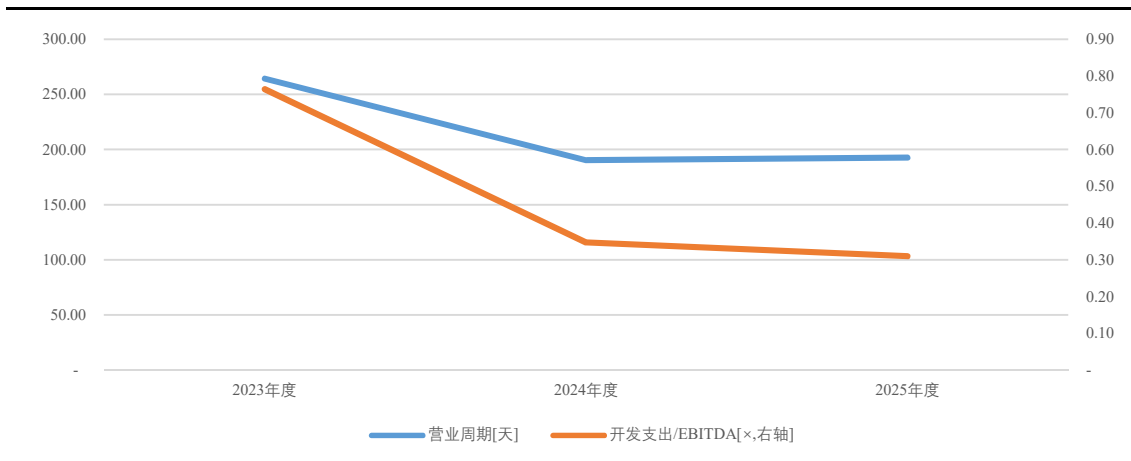
新兴市场方面，为实现先进的影像拍摄与智能感知功能，运动及全景相机、智能眼镜、端侧 AI 及机器视觉等各类新兴市场推动图像传感器的需求逐步释放，根据 IDC 数据，2025 年全球广义运动相机市场规模同比增长 72%，其中全景相机市场规模突破 12.12 亿美元，同比增长 88%；此外根据 IDC 和 Frost & Sullivan 的数据，全球智能眼镜设备市场的出货量由 2020 年的 700 万台增至 2024 年的 1,200 万台，年复合增长率为 12.6%，且预计 2029 年将达到 145 百万台，2025 年至 2029 年的年复合增长率为 61.4%。目前，公司在新兴市场的产品主要为 CIS 图像传感器、LCOS 微显示、专用 ISP/模拟芯片等产品，主要聚焦智能眼镜、运动/全景相机、机器视觉、人形机器人等领域，目前公司是全球头部运动相机品牌的核心供应商。整体来看，公司下游空间广阔，且公司是全球前三大 CMOS 图像传感器供应商之一，同下游客户缔结了长期稳定的合作关系，在诸多细分应用市场有着全球领先的市场份额，公司竞争优势较为明显。

### （3）业务专注度与成长性

该公司营业收入中来自核心业务半导体设计及销售的比重很高，主要包括图像传感器解决方案业务、显示解决方案业务及模拟解决方案业务等。2023-2025 年，公司核心业务收入分别为 179.40 亿元、216.40 亿元和 238.00 亿元，占营业收入比重超 80%。除核心业务外，公司电子元器件代理及销售业务与其属于同一行业板块，公司通过与下游模组厂商和终端厂商保持合作关系，了解市场趋势和终端厂商在研产品需求，有针对性的进行技术研发和储备，与公司半导体设计业务形成一定的协同效应。总体来看，公司下游涵盖智能手机、汽车电子、运动及全景相机、智能眼镜以及安防、医疗等多个市场，市场空间广阔。

#### (4) 经营效率

图表 9. 反映公司经营效率要素的主要指标值

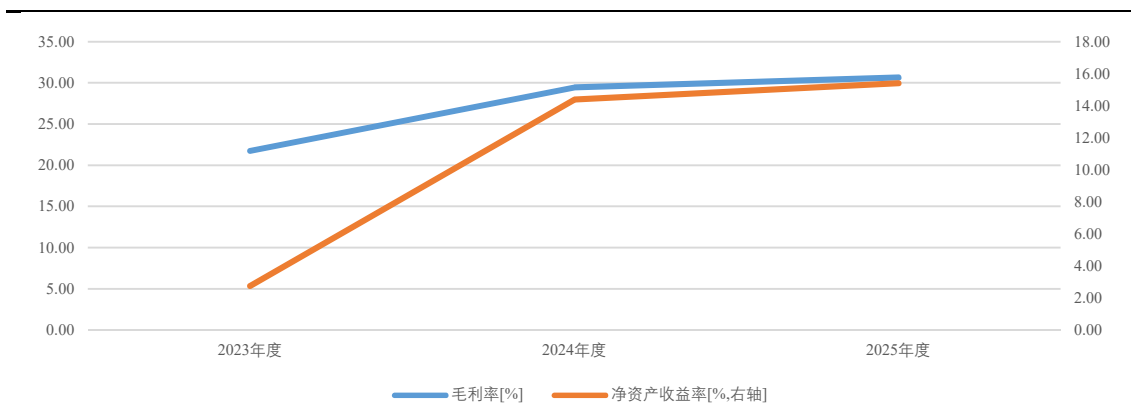


资料来源：根据豪威集团所提供数据整理、绘制。

2023-2025 年，该公司营业周期分别为 264.41 天、190.54 天和 192.74 天，受存货规模增长影响，2025 年存货周转天数及营业周期较上年有所延长。同期公司开发支出/EBITDA 分别为 0.76 倍、0.35 倍和 0.31 倍，2025 年公司经营业绩增长，EBITDA 有所上升，开发支出与 EBITDA 比例有所下降，盈利对资本化开发支出的覆盖能力较上年有所增长。

#### (5) 盈利能力

图表 10. 反映公司盈利能力要素的主要指标值



资料来源：根据豪威集团所提供数据整理、绘制。

跟踪期内，在汽车智能化渗透加速以及新兴市场开拓等因素的影响下，叠加新产品迭代以及供应链优化等因素，该公司营业毛利及毛利率水平平均同比有所增长。2025 年公司营业毛利及毛利率分别为 88.40 亿元和 30.63%，同比分别增长 16.68%和 1.19 个百分点。

2025 年，该公司期间费用及期间费用率分别为 40.30 亿元和 13.97%，同比分别增长 2.95%和下降 1.25 个百分点，期间费用控制较好。公司期间费用仍以研发费用为主，2025 年因职工薪酬增加，当年研发费用同比增长 8.42%至 28.43 亿元；同年，公司管理费用和销售费用分别为 6.96 亿元和 5.64 亿元，其中因折旧及摊销减少，当年管理费用有所下降，当年公司财务费用为-0.74 亿元，因当年存放于境外的美元存款增加，利息收入同比增长，当年公司利息收入可完全覆盖利息费用。

图表 11. 公司营业利润结构分析

| 公司营业利润结构   | 2023 年度 | 2024 年度 | 2025 年度 |
|------------|---------|---------|---------|
| 营业收入合计（亿元） | 210.21  | 257.31  | 288.55  |
| 营业毛利（亿元）   | 45.74   | 75.76   | 88.40   |

|                       |             |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 期间费用率（%）              | 17.99       | 15.21       | 13.97       |
| 其中：财务费用率（%）           | 2.17        | -0.05       | -0.26       |
| <b>全年利息支出总额（亿元）</b>   | <b>5.34</b> | <b>3.27</b> | <b>3.02</b> |
| <b>其中：资本化利息数额（亿元）</b> | <b>--</b>   | <b>--</b>   | <b>--</b>   |

资料来源：根据豪威集团所提供数据整理、计算。

该公司存货规模较大，原材料和库存商品的价格波动对公司资产减值损失造成一定影响。2025 年，公司计提资产减值损失 2.87 亿元，其中对在产品及库存商品等计提存货跌价损失 2.00 亿元，计提规模较 2024 年有所减少，但仍需关注未来因市场需求变化而导致的存货减值风险。

非经常性损益方面，2025 年该公司投资净收益为 0.12 亿元，主要来源于产业基金等其他非流动金融资产在持有期间的投资收益，当年投资收益同比有所减少主要系上年公司处置长期股权投资以及上市公司股票等其他非流动金融资产产生的投资收益规模较大。2025 年，公司公允价值变动损益为 0.74 亿元，主要是持有的上市公司股份、产业基金及非上市公司股权公允价值变化所致，同比有所增长。同年，公司营业外净收入和其他收益合计为 0.68 亿元，主要为政府补助等。2025 年，公司实现经营收益<sup>7</sup>为 44.47 亿元，同比大幅增长。

图表 12. 影响公司盈利的其他因素分析（单位：亿元）

| 影响公司盈利的其他因素 | 2023 年度 | 2024 年度 | 2025 年度 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 投资净收益       | 0.73    | 1.82    | 0.12    |
| 营业外收入       | 0.26    | 0.13    | 0.02    |
| 其他收益        | 0.60    | 0.59    | 0.73    |
| 其中：政府补助     | 0.46    | 0.51    | 0.59    |
| 公允价值变动损益    | 2.31    | 0.58    | 0.74    |

注：根据豪威集团所提供数据整理、计算。

2025 年，该公司实现营业利润和净利润分别为 46.06 亿元和 40.32 亿元，同比分别增加 13.35 亿元和 7.47 亿元。2025 年，公司净资产收益率为 15.40%，较上年增长 1.03 个百分点。整体看，受益于主营业绩增长，公司净利润水平持续提升。根据公司最新披露的《2026 年第一季度报告》，2026 年第一季度，公司实现营业收入 64.14 亿元，受存储芯片等产品供需关系出现阶段性扰动影响，消费电子、汽车电子等终端市场需求承压，当期营业收入同比下降 0.90%；同期公司毛利率为 29.38%，同比下降 1.65 个百分点，主要系受益于服务器市场需求增长，当期公司半导体代理业务收入占比较上年同期有所提升，该业务毛利率较低，导致公司整体毛利水平略有下降。

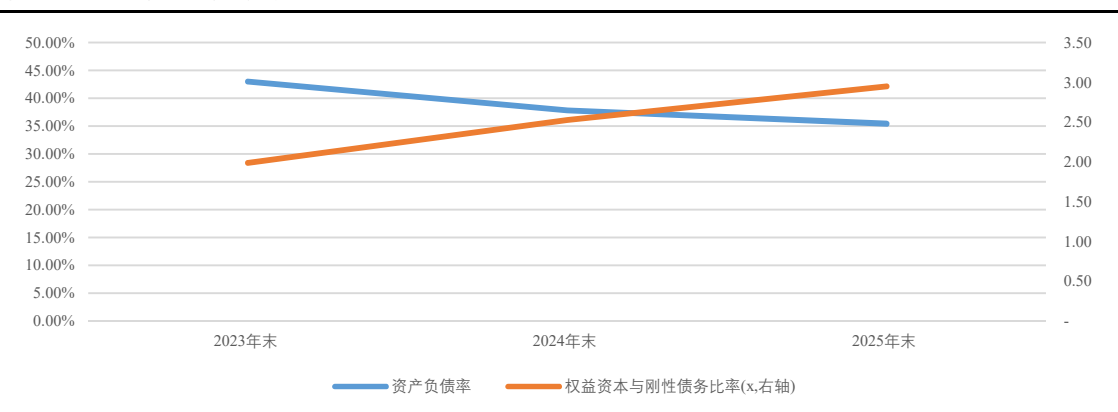
## 财务

跟踪期内，该公司债务规模小幅增长，但随着经营积累带动权益资本增长，公司财务杠杆水平有所下降，同时受益于经营业绩增长，债务偿付能力有所提升，但由于“韦尔转债”及部分长期借款即将到期，公司短期刚性债务大幅增长，需关注公司即期偿债压力。2025 年，公司销售收入有所增长，当年经营性现金保持大额净流入状态，且公司尚有较多的未受限货币资金和一定的可用授信额度，且融资渠道较为畅通，可为到期债务偿付提供较好支撑。

<sup>7</sup> 经营收益=营业利润-其他经营收益。

## 1. 财务杠杆

图表 13. 公司财务杠杆水平变动趋势



注：根据豪威集团所提供的数据整理、绘制。

2025 年末，该公司负债总额为 154.47 亿元，较上年末小幅增长 4.64%，其中刚性债务较上年末基本持平；同年末，公司权益资本为 281.54 亿元，较上年末增长 16.33%。上述因素共同作用下，2025 年末公司资产负债率为 35.43%，呈持续下降态势；年末公司权益资本与刚性债务比率为 2.95 倍，较上年末有所提升。

### (1) 资产

图表 14. 公司核心资产状况及其变动

| 主要数据及指标                 | 2023 年末     | 2024 年末     | 2025 年末     |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 流动资产（亿元，在总资产中占比%）       | 202.64      | 218.04      | 264.67      |
| 其中：货币资金（亿元）             | 53.69       | 55.96       | 60.70       |
| 其中：货币资金（亿元）             | 90.86       | 101.85      | 128.21      |
| 应收款项（亿元）                | 40.31       | 39.64       | 39.44       |
| 存货（亿元）                  | 63.22       | 69.56       | 85.98       |
| 非流动资产（亿元，在总资产中占比%）      | 174.79      | 171.60      | 171.34      |
| 其中：固定资产（亿元）             | 46.31       | 44.04       | 39.30       |
| 其中：固定资产（亿元）             | 25.86       | 31.26       | 34.42       |
| 在建工程（亿元）                | 9.04        | 5.34        | 11.25       |
| 无形资产（亿元）                | 23.05       | 22.16       | 19.96       |
| 开发支出（亿元）                | 10.45       | 10.63       | 14.01       |
| 商誉（亿元）                  | 38.61       | 36.32       | 36.19       |
| 其他非流动金融资产（亿元）           | 33.98       | 33.47       | 36.56       |
| 其他权益工具投资（亿元）            | 15.65       | 16.49       | 0.04        |
| <b>期末全部受限资产账面金额（亿元）</b> | <b>4.02</b> | <b>0.33</b> | <b>0.21</b> |
| <b>受限资产账面余额/总资产（%）</b>  | <b>1.08</b> | <b>0.08</b> | <b>0.05</b> |

注：根据豪威集团所提供数据整理、计算。

2025 年末，该公司资产总额为 436.01 亿元，较上年末增长 11.90%。公司资产仍主要为流动资产，符合其 Fabless 模式特点，期末流动资产占比为 60.70%。公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成，2025 年末占比分别为 48.44%、14.90%和 32.49%。2025 年末，公司货币资金 128.21 亿元，较上年末增长 25.88%，主要系当年销售收入增长获得较多销售回款且偿还债务规模下降所致，货币资金主要在境外且以美元为主，期末受限货币资金 0.21 亿元主要是用于担保及各项保证金；同期末，公司应收账款为 39.44 亿元，较上年末有所下降，2025 年末账龄在一年内的应收账款占比为 95.89%，前五名应收账款合计占比 29.59%，较上年末有所下降；同期末，公司存货账面价值 85.98 亿元，较上年末增长 23.61%，主要受下游需求增长影响，公司图像传感器解决方案等产品库存量增加所致，当期图像传感器产品在存货中占比约 80%。同期末公司存货中在产品 and 库存商品账面价值分别为 46.96 亿元和 38.99 亿元，较上年末分别增长 31.68%和 15.06%，2025 年增加计提存货跌价损失准备金额为 2.00 亿元，较上年末减少 1.29 亿元，截至 2025 年末公司计提存货跌价准备余额为 11.05 亿元，目前公司存

货中相关产品为标准通用品，市场价格变动不大，均已充分计提，但仍需关注未来因市场需求变化而导致的存货减值风险。

图表 15. 2025 年末公司货币资金存放情况（单位：亿元）

| 按地域分：            | 金额            | 按币种分： | 金额            |
|------------------|---------------|-------|---------------|
| 境内资金             | 18.40         | 美元    | 116.86        |
| 境外资金（含中国香港及中国台湾） | 109.81        | 港币    | 0.47          |
| 募集资金             | —             | 其他货币  | 0.71          |
| —                | —             | 人民币   | 10.17         |
| 合计               | <b>128.21</b> |       | <b>128.21</b> |

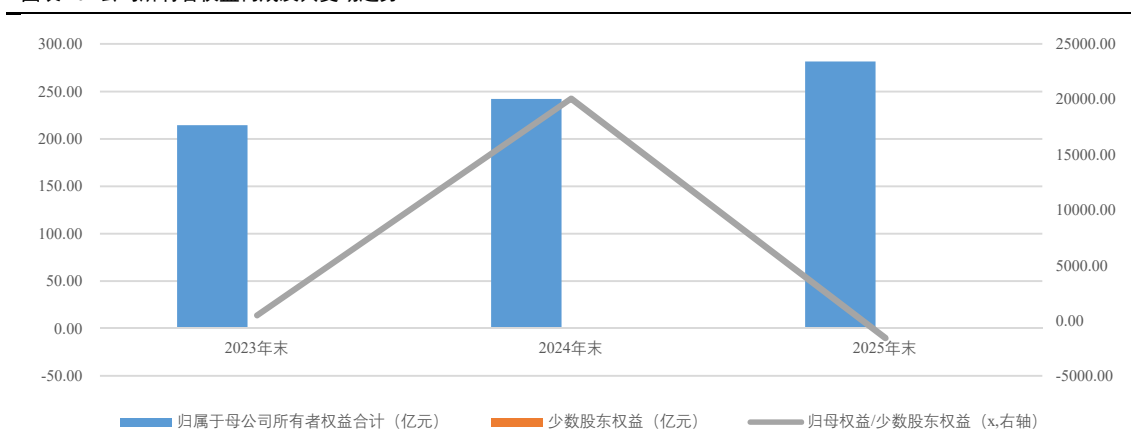
注：根据豪威集团所提供数据整理。

该公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、商誉和其他非流动金融资产构成，2025 年末占比分别为 20.09%、6.56%、11.65%、8.18%、21.12%和 21.34%。2025 年末，公司固定资产余额为 34.42 亿元，主要为研发办公建筑和相关设备等，较上年末有所增长主要是待安装设备、办公楼及附属设施等在建工程合计 9.08 亿元转固所致；在建工程余额为 11.25 亿元，主要为待安装设备 8.00 亿元和办公楼及附属设施 2.70 亿元，2025 年公司为合作的代工厂提供部分产品生产设备，当年相关待安装设备在建工程大幅增加 13.38 亿元；无形资产余额为 19.96 亿元，主要是土地使用权、专利权及专有技术、商标、自主研发等，其中公司内部研发形成的无形资产占比 53.78%；开发支出余额为 14.01 亿元，主要是图像传感器解决方案、显示解决方案等在研产品的研发支出，较上年有所增长；商誉为 36.19 亿元，因外币报表折算有所减少，截至 2025 年末，公司商誉中图像传感器解决方案业务、显示解决方案业务与模拟解决方案业务分别为 23.26 亿元、6.12 亿元和 6.81 亿元，公司商誉规模较大，需关注相关企业后续业绩变化对商誉减值的影响；2025 年末，公司其他非流动金融资产为 36.56 亿元，主要是对非上市公司股权以及产业基金等的投资，年末公司持有的非上市公司股权投资及产业基金分别为 6.33 亿元和 30.23 亿元，2025 年持有非流动金融资产带来的投资收益合计 0.35 亿元，当年处置其他非流动金融资产取得的投资收益合计 0.02 亿元。此外，2025 年末，公司其他权益工具投资为 0.04 亿元，较上年末大幅减少，主要系 2025 年 9-11 月，公司集中将所持北京君正集成电路股份有限公司（300233.SZ）合计 24,078,387 股于公开市场全部出售，合计金额 22.29 亿元（含当年公允价值变动损益）<sup>8</sup>，年末仅剩余少部分非上市公司股权。

受限资产方面，截至 2025 年末，该公司合并范围受限资产账面价值为 0.21 亿元，均为货币资金，主要用于担保及各项保证金。

## （2）所有者权益/资本补充

图表 16. 公司所有者权益构成及其变动趋势



注：根据豪威集团所提供的数据整理、绘制。

<sup>8</sup> 当年公司处置北京君正全部股票计入其他综合收益的利得 5.86 亿元，确认的股利收入 240.30 万元。

2025 年末，该公司所有者权益为 281.54 亿元，较上年末增长 16.33%，仍主要由实收资本、资本公积和未分配利润构成，2025 年末占比分别为 4.30%、39.66%和 53.86%。2025 年末，公司实收资本较上年末减少 0.52%至 12.10 亿元，主要系 2025 年 8 月公司注销回购股份 11,213,200 股所致，本次回购注销股份减少股本 0.11 亿元，减少资本公积 9.89 亿元，减少库存股 10.00 亿元，当年末公司资本公积较上年末减少 3.29%至 111.66 亿元，库存股大幅减少至 3.48 亿元。2025 年末，得益于经营业绩增长，公司未分配利润较上年末增长 27.77%至 151.64 亿元。现金分红方面，2025 年 8 月，公司完成了 2024 年度利润分配，合计现金分红 2.64 亿元，并于同年 11 月完成 2025 年度中期利润分配，合计现金分红 4.82 亿元；2026 年 3 月，公司发布 2025 年度利润分配预案，公司拟每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计现金分红 1.26 亿元，未来利润分配情况对权益资本的影响需持续关注。2025 年末，公司少数股东权益为-0.18 亿元，主要系个别子公司持续亏损导致少数股东损益变为负数所致。

根据该公司于 2025 年 5 月发布的《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》，为加快公司的国际化战略及海外业务发展，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市。经中国证监会备案并经香港联合交易所有限公司上市委员会批准，公司于 2025 年 12 月 31 日在香港联交所网站刊发 H 股招股说明书。2026 年 1 月 12 日，公司完成全球发售并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，发行 45,800,000 股 H 股，发行价格为每股 104.80 港元（不含经纪佣金及相关征费）；2026 年 2 月 6 日，整体协调人部分行使超额配售权；2026 年 2 月 11 日，公司按相同发行价格额外发行 4,941,100 股 H 股。超额配售权部分行使后，公司累计发行 50,741,100 股 H 股，募集资金总额约为 53.18 亿港元。本次发行 H 股股票所募集资金净额约 46.77 亿人民币，其中约 70%将在未来五至十年用于投资关键技术的研发，保证公司在先进传感技术、先进显示技术及模拟解决方案的持续领先地位；约 10%将在未来五至十年用于强化全球市场渗透及业务扩张；约 10%将用于战略投资及/或收购，重点聚焦能与公司现有产品组合产生协同效应、提升公司的设计能力、工艺技术与供应链能力及支持向新兴领域横向拓展的投资和收购机遇；约 10%将用于营运资金及一般公司用途。

### （3） 负债

图表 17. 公司债务结构及核心债务（单位：亿元）

| 主要数据及指标      | 2023 年末 | 2024 年末 | 2025 年末 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 刚性债务         | 107.95  | 95.65   | 95.39   |
| 其中：短期刚性债务    | 53.74   | 35.69   | 79.21   |
| 中长期刚性债务      | 54.21   | 59.96   | 16.18   |
| 应付账款         | 16.63   | 19.35   | 22.35   |
| 预计负债         | 9.44    | 4.33    | 4.73    |
| 其他应付款        | 11.66   | 11.33   | 13.31   |
| 综合融资成本（年化，%） | 4.47    | 2.62    | 2.54    |

注：根据豪威集团所提供数据整理、计算。

从债务期限结构来看，该公司负债仍以流动负债为主，2025 年末公司长短期债务比为 22.73%，因部分长期借款及应付债券重分类至一年内到期的非流动负债，当年末长短期债务比大幅下降。

该公司债务中刚性债务占比最大，2025 年末为 61.76%，此外公司主要负债还有应付账款、其他应付款和预计负债等。2025 年末，公司应付账款为 22.35 亿元，较上年末增长 15.45%，主要系 2025 年以来下游客户需求增长带动公司采购增加所致；其他应付款为 13.31 亿元，较上年末增长 17.51%，主要为应付销售返点等；预计负债为 4.73 亿元，主要为公司在海外的经营活动产生的不确定税项等，较 2024 年末有所增长。

2025 年末，该公司刚性债务规模较上年末基本持平，但短期刚性债务占比由上年末的 37.31%大幅上升至 83.04%。同年末，公司短期刚性债务为 79.21 亿元，其中短期借款 20.79 亿元，较上年末有所增长，一年内到期的长期借款 32.90 亿元，一年内到期的应付债券 25.53 亿元，因“韦尔转债”将于 2026 年 12 月到期，公司将其重分类至一年内到期的非流动负债，公司短期刚性债务大幅增长。2025 年末，公司长期刚性债务为 16.18 亿元，均为长期借款，因部分重分类至一年内到期的非流动负债而有所下降。整体来看，公司刚性债务仍主要为银行借款和应付债券，2025 年末分别为 69.87 亿元和 25.53 亿元，其中银行借款主要为信用借款，2025 年末占比超过 90%，其他还包括少量的银行承兑票据贴现及保证借款。此外，同期末“韦尔转债”累计转股 35,059 股，尚未转股额

24.32 亿元，目前转股规模不大，若未来转股不达预期，或将加重公司债务负担。随着公司短期借款规模增长，且“韦尔转债”即将到期，需关注公司即期偿债压力。

从融资成本看，跟踪期内受益于银行贷款利率下行，该公司综合融资成本为 2.54%，较上年继续下降，截至 2025 年末公司存续的银行借款融资成本区间为 1.95%~2.51%。

## 2. 偿债能力

### (1) 现金流量

图表 18. 公司现金流量状况

| 主要数据及指标                          | 2023 年度       | 2024 年度       | 2025 年度      |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>经营环节产生的现金流量净额（亿元）</b>         | <b>75.37</b>  | <b>47.72</b>  | <b>41.20</b> |
| 其中：业务现金收支净额（亿元）                  | 77.56         | 48.72         | 41.14        |
| <b>投资环节产生的现金流量净额（亿元）</b>         | <b>-24.64</b> | <b>-8.11</b>  | <b>-8.20</b> |
| 其中：回收投资与投资支付净流入额（亿元）             | -14.12        | 4.10          | 15.27        |
| 购建与处置固定资产、无形资产及其他长期资产形成的净流入额（亿元） | -10.42        | -12.21        | -23.25       |
| <b>筹资环节产生的现金流量净额（亿元）</b>         | <b>-0.64</b>  | <b>-30.07</b> | <b>-4.37</b> |
| 其中：现金利息支出（亿元）                    | 4.69          | 2.49          | 2.36         |

注：根据豪威集团所提供数据整理、计算。

注：业务现金收支净额是指不包括其他因素导致的现金收入与现金支出的经营环节现金流量净额。

该公司主业收现能力较强，2025 年公司营业收入现金率为 97.83%，同比有所下降。2025 年，随着下游需求增长，公司持续增加备货，当年购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 7.37%至 209.25 亿元，使得当年经营性现金净流入额同比减少 13.67%至 41.20 亿元。

2025 年，该公司投资性现金流量净额为-8.20 亿元，其中回收投资与投资支付净额为 15.27 亿元，主要涉及对产业基金、股权投资等其他权益工具投资、非流动金融资产以及理财产品等的处置与申赎，跟踪期内规模同比有所增长，主要系当年公司处置所持的北京君正股权收到现金 22.29 亿元。项目投资方面，2025 年公司购建与处置固定资产、无形资产及其他长期资产净额为-23.25 亿元，净流出规模同比增长，主要待安装设备等项目建设支出同比增长所致。

2025 年，该公司筹资性现金流量净额为-4.37 亿元，近年来波动较大，2025 年因偿还债务及股份回购规模同比减少，当年筹资性现金净流出额有所下降。

### (2) 偿债能力

图表 19. 公司偿债能力指标值

| 主要数据及指标        | 2023 年度 | 2024 年度 | 2025 年度 |
|----------------|---------|---------|---------|
| EBITDA（亿元）     | 23.92   | 49.00   | 62.10   |
| EBITDA/利息支出（倍） | 4.48    | 15.00   | 20.53   |
| EBITDA/刚性债务（倍） | 0.20    | 0.48    | 0.65    |

资料来源：根据豪威集团所提供数据整理、计算。

2025 年该公司 EBITDA 为 62.10 亿元，同比增长主要系当年公司利润总额增长 13.23 亿元至 46.01 亿元所致。2025 年 EBITDA 对刚性债务及利息支出的覆盖倍数分别为 0.65 倍和 20.53 倍，较去年均有提升。

## 调整因素

### 1. 流动性/短期因素

图表 20. 公司资产流动性指标值

| 主要数据及指标  | 2023 年末 | 2024 年末 | 2025 年末 |
|----------|---------|---------|---------|
| 流动比率 (%) | 223.45  | 287.07  | 210.28  |
| 速动比率 (%) | 151.31  | 192.18  | 139.60  |
| 现金比率 (%) | 103.68  | 135.89  | 105.50  |

资料来源：根据豪威集团所提供数据整理、计算。

2025 年末，该公司流动比率和速动比率分别为 210.28% 和 139.60%，2025 年以来流动负债规模增长，当年末公司流动性水平有所下降，且考虑到流动资产中存货规模占据一定比例，其实际资产流动性弱于指标所示。跟踪期内，公司经营性现金流持续呈大额净流入状态，货币资金规模较 2024 年末增长，但受短期债务规模增长影响，现金类资产对债务偿付保障能力有所下降，此外需关注货币资金与债务的境内外配置事项。

该公司历年来与银行等金融机构保持了良好的合作关系，并能持续获得金融机构一定规模的授信额度，截至 2025 年末，公司合并范围获得的银行综合授信总额为 145.69 亿元，尚未使用额度为 45.46 亿元。

### 2. ESG 因素

跟踪期内，该公司实际控制人仍为虞仁荣先生，但持股比例较 2024 年末有所下降，其中 2025 年 12 月，控股股东虞仁荣将其持有的 30,000,000 股无限售条件流通股无偿捐赠给宁波东方理工大学教育基金会<sup>9</sup>，捐赠后其持股比例从 27.57% 降至 25.09%。截至 2025 年末，虞仁荣及其一致行动人合计持股比例为 31.30%，其中虞仁荣直接持股 25.09%、一致行动人虞小荣和绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别持有 0.08% 和 6.13% 股权，其中虞仁荣及其一致行动人合计质押公司股份 1.88 亿股，占其持有公司股份总数的 49.57%，质押比例较高，需关注实控人股权质押风险。

2025 年，该公司更名为现名并对公司章程及相关治理制度进行了修订。人事变动方面，2025 年 6 月，公司完成了董事会换届选举，同时聘任徐兴先生为公司财务总监。2025 年 11 月，公司总经理及法定代表人王崧先生因工作内容调整申请辞去公司总经理职务，不再担任公司法定代表人，公司董事会聘任高文宝博士为公司总经理及法定代表人，聘任王崧先生为公司副总经理。2026 年 3 月，贾渊先生申请辞去所担任公司的董事、副总经理职务，公司董事会提名高文宝博士为公司董事候选人，并委任高文宝博士替代贾渊先生为公司于《香港上市规则》第 3.05 条下的授权代表，相关事项已于 2026 年 5 月经公司 2025 年年度股东会审议通过。

根据该公司提供的 2026 年 4 月 8 日的《企业信用报告》及相关资料，跟踪期内公司不存在借款违约及欠息事项。经查询国家企业信用信息公示系统，公司不存在行政处罚。公司在信息透明度方面不存在重大缺陷，未出现延期披露财务报表，已披露财务报表未出现重大会计差错；未受到监管处罚。在社会责任方面，跟踪期内公司主动承担社会责任，2025 年公司对外捐赠及公益项目总投入 5.55 万元。在环境方面，公司及子公司均不属于重点排污单位，跟踪期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 3. 表外事项

截至 2025 年末，该公司无对外担保，已背书或贴现且尚未到期的应收票据约为 6.67 亿元。

2023 年 5 月 10 日，美国专利授权公司 Greenthread, LLC 向得克萨斯州东区地区法院提起专利权侵权诉讼（案号 2:23-cv-00212），起诉美国豪威侵犯其六项专利权。该公司认为上述控诉缺乏事实依据，并会坚决予以辩护。根据公司管理层聘请的律师的法律意见和本案件的进展情况，现阶段公司管理层认为不能根据该诉讼现状合理可靠地预测其结果可能造成损失，截至 2025 年末公司并未对该诉讼计提预计负债。美国专利商标局于 2026 年 2

<sup>9</sup> 宁波东方理工大学为虞仁荣设立的教育基金会举办、浙江省和宁波市政府重点支持筹建的新型研究型大学。截至目前，虞仁荣及其一致行动人已多次向宁波东方理工大学教育基金会无偿捐赠其持有的公司无限售条件流通股用于大学基础设施建设等。

月 3 日驳回了 Greenthread 所有复审请求，因此相关专利权利要求已被最终认定为无效。Greenthread 可在两个月内向美国联邦巡回上诉法院提起上诉，目前地区法院的诉讼程序仍处于中止状态。

2025 年 4 月，该公司子公司豪威触控与显示科技（深圳）有限公司（简称“豪威触控与显示”）的几位少数股东向上海仲裁委员会提起仲裁申请，请求公司回购其所持的豪威触控与显示的股权。此仲裁已于 2025 年 7 月 18 日开庭，截至 2026 年 3 月末，仲裁庭尚未作出裁决，根据公司管理层聘请的律师的法律意见和本案件的进展情况，现阶段公司管理层认为不能根据该仲裁现状合理可靠地预测其结果。截至 2025 年末，公司并未对该诉讼仲裁计提预计负债。

#### 4. 其他因素

该公司关联交易及资金往来等规模较小。2025 年，公司向关联方采购商品/接受劳务金额合计 0.35 亿元；向关联方出售商品/提供劳务金额合计 0.01 亿元。关联担保方面，公司为子公司上海豪威集成电路集团有限公司提供贷款担保合计 1.58 亿元。关联资金往来方面，2025 年末公司应收关联方应收账款、长期应收款账面余额合计 0.91 亿元，主要为兴豪通信技术（浙江）有限公司的应收款项 0.88 亿元；当年公司应付关联方应付账款、其他应付款账面余额合计 0.02 亿元，主要为对上海韦城公寓管理有限公司的其他应付款。

### 同业比较分析

新世纪评级选取了烽火通信科技股份有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司以及上海富瀚微电子股份有限公司作为该公司的同业比较对象。上述主体均以半导体为主业的发债公司，具有较高的可比性。

该公司技术研发体系完备，研发投入很高，技术支撑下业务盈利能力较强，财务杠杆处于较低水平但权益资本对刚性债务覆盖程度相对较弱。

### 债项信用跟踪分析

#### 1. 债项主要条款跟踪分析

本次债券设置发行人赎回条款及投资者回售选择权。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，该公司将赎回未转股的可转债；在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果该公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，投资者有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。回售条款的设置，使公司面临一定的提前偿付压力。

本次债券发行规模较大，截至 2025 年末，“韦尔转债”累计转股 35,059 股，尚未转股额 24.32 亿元，目前转股规模小，该债券将于 2026 年 12 月到期，若未来转股不达预期，则该公司需偿还债券本息，或将加重刚性债务负担。

#### 2. 偿债保障措施跟踪分析

跟踪期内该公司主要通过银行贷款进行融资，公司融资渠道畅通，资本补充能力较强。

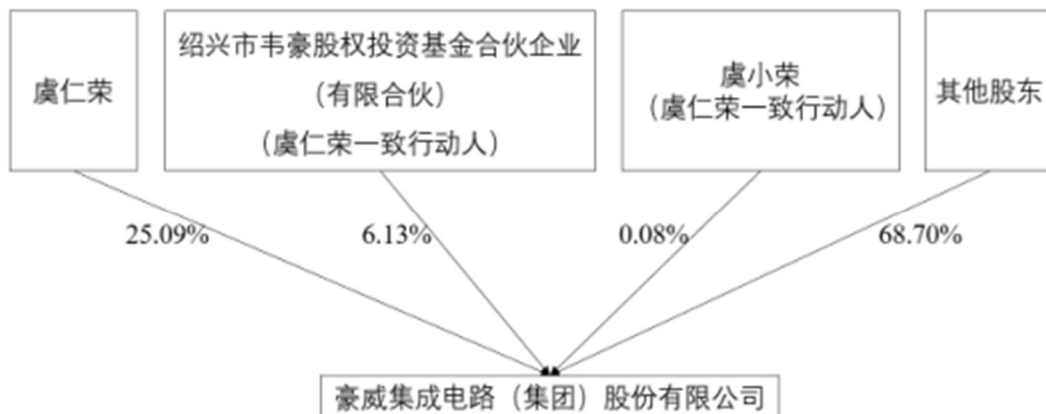
跟踪期内该公司流动性水平有所提升，预计未来仍将保持较高水平，且期内公司利润增长较快，EBITDA 对债务的覆盖程度有所提升，公司整体偿债保障能力较强。

## 跟踪评级结论

综上，本评级机构评定豪威集团主体信用等级为 AA<sup>+</sup><sub>st1</sub>，评级展望为稳定，韦尔转债信用等级为 AA<sup>+</sup>。

附录一：

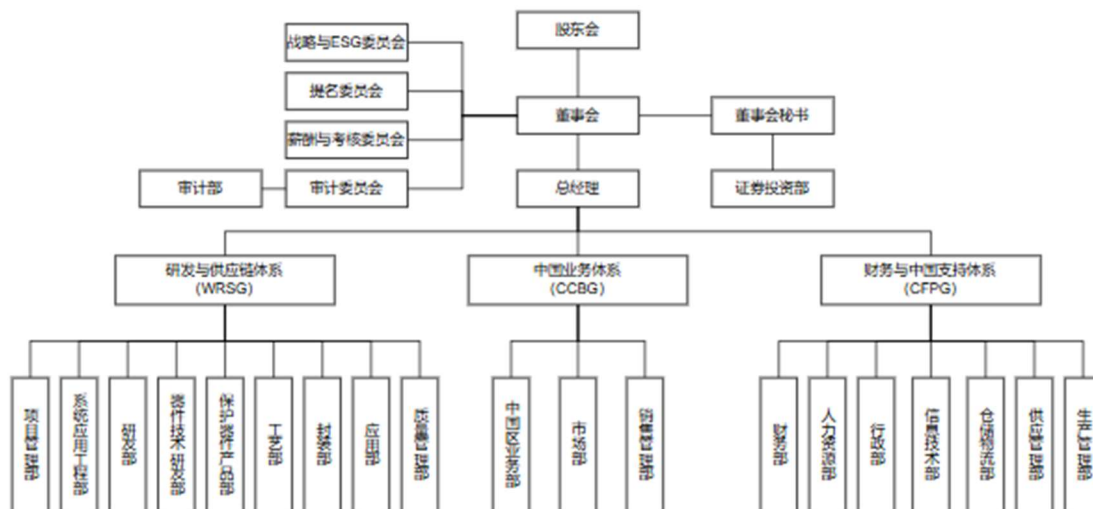
### 公司与实际控制人关系图



注：根据豪威集团提供的资料整理绘制（截至 2025 年末）。

附录二：

### 公司组织结构图



注：根据豪威集团提供的资料整理绘制（截至 2025 年末）。

附录三：

### 相关实体主要数据概览

| 基本情况             |      |       |            |                       | 2025年（末）主要财务数据（亿元） |        |        |       |           | 备注    |
|------------------|------|-------|------------|-----------------------|--------------------|--------|--------|-------|-----------|-------|
| 全称               | 简称   | 与公司关系 | 母公司持股比例（%） | 主营业务                  | 刚性债务余额             | 所有者权益  | 营业收入   | 净利润   | 经营环节现金净流量 |       |
| 豪威集成电路（集团）股份有限公司 | 豪威集团 | 本级    | —          | 半导体产品研发设计、销售、电子元器件分销等 | 78.89              | 220.20 | 32.22  | 12.46 | -11.79    | 母公司口径 |
| 北京豪威科技有限公司       | 北京豪威 | 子公司   | 100.00     | 半导体产品研发设计及销售          | 0.00               | 237.24 | 211.97 | 39.13 | 42.69     |       |

注：根据豪威集团2025年度审计报告附注及所提供的其他资料整理。

附录四：

### 同类企业比较表

核心业务：集成电路设计 归属行业：半导体

| 企业名称（全称）         | 最新主体<br>信用等级/展望                    | 2025 年度经营数据 |              |                        |            |                   | 2025 年末财务数据/指标 |             |               |                      |                        |                        |
|------------------|------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                  |                                    | 营业周期<br>（天） | 营业收入<br>（亿元） | 开发支出<br>/EBITDA<br>（倍） | 毛利率<br>（%） | 净资产收益<br>率<br>（%） | 资产负债率<br>（%）   | 总资产<br>（亿元） | 所有者权益<br>（亿元） | 权益资本/刚性<br>债务<br>（倍） | EBITDA/利息支<br>出<br>（倍） | EBITDA/刚性债<br>务<br>（倍） |
| 上海富瀚微电子股份有限公司    | A <sup>+</sup> <sub>stt</sub> /稳定  | 260.05      | 16.90        | 0.53                   | 37.18      | 3.96              | 25.28          | 41.48       | 30.99         | 4.35                 | 10.18                  | 0.47                   |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司   | AAA/稳定                             | 127.03      | 1,647.82     | 0.04                   | 4.88       | 11.56             | 73.64          | 837.94      | 220.92        | 2.05                 | 11.47                  | 0.34                   |
| 烽火通信科技股份有限公司     | AAA/稳定                             | 399.44      | 249.19       | 0.61                   | 21.10      | 2.77              | 59.49          | 471.82      | 191.11        | 1.63                 | 6.43                   | 0.16                   |
| 豪威集成电路（集团）股份有限公司 | AA <sup>+</sup> <sub>stt</sub> /稳定 | 192.74      | 288.55       | 0.31                   | 30.63      | 15.40             | 35.43          | 436.01      | 281.54        | 2.95                 | 20.53                  | 0.65                   |

注：烽火通信科技股份有限公司及浪潮电子信息产业股份有限公司相关数据及指标来自公开市场可获取数据及计算，或存在一定局限性。

附录五：

主要财务数据及指标

| 主要财务数据与指标[合并口径]   | 2023 年/末 | 2024 年/末 | 2025 年/末 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 资产总计[亿元]          | 377.43   | 389.65   | 436.01   |
| 负债合计[亿元]          | 162.48   | 147.62   | 154.47   |
| 其中：刚性债务余额[亿元]     | 107.95   | 95.65    | 95.39    |
| 其中：短期刚性债务余额[亿元]   | 53.74    | 35.69    | 79.21    |
| 所有者权益合计[亿元]       | 214.95   | 242.02   | 281.54   |
| EBITDA[亿元]        | 23.92    | 49.00    | 62.10    |
| 经营活动产生的现金流量净额[亿元] | 75.37    | 47.72    | 41.20    |
| 营业周期[天]           | 264.41   | 190.54   | 192.74   |
| 开发支出/EBITDA[×]    | 0.76     | 0.35     | 0.31     |
| 毛利率[%]            | 21.76    | 29.44    | 30.63    |
| 毛利率*[%]           | 19.54    | 27.28    | 28.68    |
| 净资产收益率[%]         | 2.75     | 14.37    | 15.40    |
| 净利润增长率[%]         | -43.25   | 503.93   | 22.76    |
| 资产负债率[%]          | 43.05    | 37.89    | 35.43    |
| 权益资本/刚性债务[×]      | 1.99     | 2.53     | 2.95     |
| EBITDA/刚性债务[×]    | 0.20     | 0.48     | 0.65     |
| EBITDA/利息支出[×]    | 4.48     | 15.00    | 20.53    |

注：表中数据依据豪威集团经审计的 2023~2025 年度财务数据整理、计算。

指标计算公式

|   |
|---|
| 刚性债务=期末短期借款+期末应付票据+期末应付利息+期末应付短期债务+期末一年内到期的非流动负债+期末长期借款+期末应付债券+期末其他刚性债务 |
| EBITDA=报告期利润总额+报告期列入财务费用的利息支出+报告期固定资产折旧+报告期无形资产及其他资产摊销                  |
| 营业周期（天）=报告期应收账款周转天数+报告期存货周转天数   |
| 开发支出/EBITDA[×]=[期末开发支出+期末无形资产（知识产权类资产）]/EBITDA                          |
| 毛利率[%]=（报告期营业收入-报告期营业成本）/报告期营业收入×100%                                   |
| 毛利率*[%]=1-（报告期营业成本+报告期销售费用）/报告期营业收入×100%                                |
| 净资产收益率[%]=报告期净利润[（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）/2]×100%                          |
| 资产负债率[%]=期末负债总额/期末资产总额×100%   |
| 权益资本/刚性债务[×]=期末所有者权益合计/期末刚性债务余额   |
| EBITDA/刚性债务[×]=报告期 EBITDA/[（期初刚性债务余额+期末刚性债务余额）/2]                       |
| EBITDA/利息支出[×]=报告期 EBITDA/(报告期列入财务费用的利息支出+报告期资本化利息)                     |

上述指标计算以公司合并财务报表数据为准。

附录六：

## 评级结果释义

本评级机构科技创新企业主体信用等级划分及释义如下：

| 信用等级                 | 含义   |
|----------------------|--|
| AAA <sub>sti</sub> 级 | 发行人具有科技创新属性，其偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 |
| AA <sub>sti</sub> 级  | 发行人具有科技创新属性，其偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。  |
| A <sub>sti</sub> 级   | 发行人具有科技创新属性，其偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。   |
| BBB <sub>sti</sub> 级 | 发行人具有科技创新属性，其偿还债务能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般。    |
| BB <sub>sti</sub> 级  | 发行人具有科技创新属性，其偿还债务能力较弱，受不利经济环境影响很大，违约风险较高。    |
| B <sub>sti</sub> 级   | 发行人具有科技创新属性，其偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高。    |
| CCC <sub>sti</sub> 级 | 发行人具有科技创新属性，其偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高。     |
| CC <sub>sti</sub> 级  | 发行人具有科技创新属性，其在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务。      |
| C <sub>sti</sub> 级   | 发行人具有科技创新属性，其不能偿还债务。                         |

注：除 AAA<sub>sti</sub> 级、CCC<sub>sti</sub> 级及以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

本评级机构中长期债券信用等级划分及释义如下：

| 信用等级  | 含义                               |
|-------|----------------------------------|
| AAA 级 | 债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 |
| AA 级  | 债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。  |
| A 级   | 债券的偿付安全性较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。  |
| BBB 级 | 债券的偿付安全性一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般。   |
| BB 级  | 债券的偿付安全性较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险。  |
| B 级   | 债券的偿付安全性较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高。    |
| CCC 级 | 债券的偿付安全性极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高。     |
| CC 级  | 在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债券本息。     |
| C 级   | 不能偿还债券本息。                        |

注：除 AAA 级、CCC 级及以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

## 发行人历史评级

附录七：

| 评级类型 | 评级情况分类 | 评级时间       | 评级结果                              | 评级分析师   | 所使用评级方法和模型的名称及版本   | 报告（公告）链接 |
|------|--------|------------|-----------------------------------|---------|--|----------|
| 主体评级 | 历史首次评级 | 2020年8月3日  | AA+/稳定                            | 陈思阳、翁斯喆 | 新世纪评级方法总论(2012)<br>电子信息制造业信用评级方法(2018)<br>工商企业评级模型(电子信息制造)MX-GS006(2019.8) | 报告链接     |
|      | 前次评级   | 2025年6月12日 | AA+/稳定                            | 翁斯喆、黄梦蛟 | 新世纪评级方法总论(2022)<br>工商企业评级方法与模型(科技创新企业)FM-GS028(2024.4)                     | 报告链接     |
|      | 本次评级   | 2026年5月21日 | AA <sup>+</sup> <sub>sd</sub> /稳定 | 黄梦蛟、郝泽  | 新世纪评级方法总论(2022)<br>工商企业评级方法与模型(科技创新企业)FM-GS028(2024.4)                     | =        |
| 债项评级 | 历史首次评级 | 2020年8月3日  | AA <sup>+</sup>                   | 陈思阳、翁斯喆 | 新世纪评级方法总论(2012)<br>电子信息制造业信用评级方法(2018)<br>工商企业评级模型(电子信息制造)MX-GS006(2019.8) | 报告链接     |
|      | 前次评级   | 2025年6月12日 | AA <sup>+</sup>                   | 翁斯喆、黄梦蛟 | 新世纪评级方法总论(2022)<br>工商企业评级方法与模型(科技创新企业)FM-GS028(2024.4)                     | 报告链接     |
|      | 本次评级   | 2026年5月21日 | AA <sup>+</sup>                   | 黄梦蛟、郝泽  | 新世纪评级方法总论(2022)<br>工商企业评级方法与模型(科技创新企业)FM-GS028(2024.4)                     | =        |

注：上述评级方法及相关文件可于新世纪评级官方网站查阅，历史评级信息仅限于本评级机构对发行人进行的评级。